

FID2

FID3

FID1

*El diseno se realiza con los siguientes parametros:*

- \* Ancho de pista de 0.8 mm.*
- \* Pads de COBRE con recubrimiento de FLUX.*
- \* Mascara antisoldante verde.*
- \* Terminacion superficial de pads HASL.*
- \* Grilla de 1mm para Posicionamiento y 0,5mm para Routeo.*
- \* Pad minimo 0,7 mm*
- \* Espesor de placa (standard) 1.6 mm.*
- \* Espesor de cobre (standard) 35 um.*
- \* Material de Sustrato: FR4.*
- \* DOBLE FAZ con componentes unicamente en la capa frontal.*
- \* Se desea mantener un margen de 2 mm en toda la periferia de la placa, exceptuando el lado superior (para conexion de modulo RF)*
- \* Margen entre componentes de 0,6 mm.*
- \* Fabricacion Manual, en su defecto (Mayer Argenitna).*